SP-525

硅胶软性透明灌封胶

用　　途

适用于电气及电子零组件固定、绝缘、密封、保护等应用。

特　　点

- SP-525 为水状透明灌封胶，混合容易，流动性佳，操作方便，可采用常温硬化或是加温硬化。
- 硬化后可在-65° C ~ +200° C 温度范围长期保持弹性。
- 柔软性好，对于机械性振动可提供一定缓冲性，具有优良的电气绝缘特性和化学稳定性。
- 对于一般金属以及非金属材料等无腐蚀性，并具有良好的柔韧性。

物　　性

		A 剂		B 剂
颜　　色		透明		透明
黏　　度	@25° C	1,000-1,400 cps		1,000-1,400cps
混 合 比	重量比	1	:	1
表面硬化时间	@25° C	4 ~ 6 小时		
绝 缘 常 数	1MHz	3.0		
消 散 因 子	1MHz	0.0021		
绝 缘 强 度		18 kV/mm		
体 积 电 阻		1 x 10^{14} ohm-cm		
保 存 期 限	@25°C、未开封	6 个月		

注 意 事 项

1. 使用前，请先将混合用器具、欲灌注基板或模块表面清洁干净。以免混入杂质或污染，影响透明度或造成灌注成品外观不佳。
2. 如果灌胶成品内部包裹气泡，建议降低灌胶深度，分次灌胶。或是在灌胶前后对于树脂或灌注模块进行真空脱泡，以获得最佳外观。
3. 部分含有硫、磷、氮元素的有机化合物，可能会抑制或干扰硫化反应，而造成不易硬化。对于有使用脱模剂、含硫材料、或基板上有助焊剂残留物、有机金属化合物等，请先少量适用确定是否有影响，或是灌胶前加强清洁的工作。
4. 开封后请尽速用完，或是密封避免受潮，使用时亦避免接触到水或其它化学物质。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 · FAX：021-58356976